证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2022-050

深圳至正高分子材料股份有限公司关于上海证券交易所《关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外收购事项的问询函》部分回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、盈利预测无法实现的风险。在制定收入预测时,标的公司统计了短期内客户扩建/更新对标的公司产品采购的潜在需求,其中2023年大部分、2024年全部需求是基于标的公司与客户的沟通进行预测的,尚未实际签署订单。该预测最终能否实现具有一定的不确定性,将取决于行业未来发展趋势、标的公司经营管理能力、疫情及半导体行业波动等多种因素影响,存在预测无法实现的风险。

2、业绩承诺约束力不足的风险。SUCCESS FACTORS承诺标的公司2022年、2023年、2024年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1,350万元、1,890万元、2,646万元。根据标的公司提供的未经审计的财务数据,2022年前三季度,标的公司已实现净利润1,365.96万元。尽管2022年前三季度实现的未经审计的净利润不代表标的资产已实现2022年业绩承诺,但标的公司仍存在2022年业绩超额实现、业绩承诺约束力不足的风险。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)于2022年11月9日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外收购事项的问询函》(上证公函【2022】2639号,以下简称“《问询函》”),公司高度重视并会同会计师、评估师、公司全体董事、监事、高级管理人员对《问询函》中的问题进行了认真、系统的核查。

本次问询共涉及6个问题,问题3“(2)标的资产的主要经营模式,并结合标的资产的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率等,分析标的资产的行业地位和竞争优势;(3)结合上述情况,说明标的资产第三季度业绩大幅提升的具体原因,与行业趋势是否相符,并分析标的资产盈利能力的可持续性;”中标的公司的业务模式、持续盈利模式等部分内容还需要进一步补充和完善,公司将尽快完善回复内容,并及时披露。

现将其他内容回复如下:

问题1.公司目前主营电线电缆用高分子材料,公告披露,本次收购标的主营半导体专用设备,与公司目前主业无关。公告称实施本次交易旨在从原有的电线电缆用高分子材料业务向半导体设备领域拓展,提升公司盈利能力。同时,公司今年前三季度营业收入7,322.96万元且经营亏损。根据本所《股票上市规则》9.3.2条规定,若最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,将被实施退市风险警示。请公司:(1)结合公司主营业务及发展战略,标的资产的市场地位、经营情况,说明跨界收购的原因及必要性;(2)结合公司在半导体领域已有的技术、人才储备、市场资源等,说明公司是否具备充足的资金投入能力和业务整合能力,本次收购决策是否审慎合理,是否符合公司发展战略,并充分提示该投资事项可能面临的风险;(3)结合公司本年度目身经营情况,说明若不进行本次收购,公司今年业绩是否可能触及退市风险警示相关指标,本次收购是否涉及年末突击交易。请公司全体董监高发表意见。

答复:

一、结合公司主营业务及发展战略,标的资产的市场地位、经营情况,说明跨界收购的原因及必要性

(一)公司现有业务逐年下滑,亟需开拓新的利润增长点

本次交易前,公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。近年来,受下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能影响,电线电缆行业一度出现规模下滑,行业整体景气度不高。同时,受国际原油等大宗商品价格大幅上涨影响,公司主要原材料采购价格相应上涨,公司产品的生产成本大幅上升。此外,2022年上半年上海地区的疫情导致公司生产经营受到较大不利影响。最近三年一期,公司营业收入呈下滑趋势,净利润持续亏损,具体情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	7,322.96	12,813.60	31,131.62	46,186.56
同比变动比例	-29.05%	-58.84%	-32.60%	-18.94%
净利润	-998.00	-5,342.93	-4,807.96	-5,705.42
同比变动比例	38.89%	-11.13%	15.73%	-266.78%

为扭转公司现状,维护公司及中小股东的利益,公司制定了“内生+外延”的发展战略,在采取策略应对主业承压的同时,积极寻求新的业务发展机遇,通过外延式并购调整业务布局,谋求第二主业,寻找新的利润增长点,以提升公司整体业绩。

(二)国产半导体设备市场需求有较大提升空间,符合公司战略方向

半导体产业是信息技术发展的核心基础,是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展,从政策和资金上对国内半导体产业给予了大力扶持。半导体设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试工序和实现技术进步的关键。由于我国半导体设备产业整体起步较晚,目前国产规模仍然较小,国产化提升空间较大。2016-2021年,中国大陆的半导体设备市场规模从64.6亿美元增长到了296.2亿美元,年CAGR达36%,在全球市场中的占比由15.7%提升至28.86%。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模从64.6亿美元增长到296.2亿美元,年CAGR达36%,在全球市场中的占比由15.7%提升至28.86%。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。

市场规模方面,中国大陆的半导体设备市场规模从2016年的64.6亿美元增长到2021年的296.2亿美元,年复合增长率(CAGR)为36%,高于全球同期的复合增长率。2021年,中国大陆的半导体设备市场规模占全球市场的28.86%,仅次于韩国(31.03%)和中国台湾(29.04%)。

(三)公司现有业务逐年下滑,亟需开拓新的利润增长点

本次交易前,公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。近年来,受下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能影响,电线电缆行业一度出现规模下滑,行业整体景气度不高。同时,受国际原油等大宗商品价格大幅上涨影响,公司主要原材料采购价格相应上涨,公司产品的生产成本大幅上升。此外,2022年上半年上海地区的疫情导致公司生产经营受到较大不利影响。最近三年一期,公司营业收入呈下滑趋势,净利润持续亏损,具体情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	7,322.96	12,813.60	31,131.62	46,186.56
同比变动比例	-29.05%	-58.84%	-32.60%	-18.94%
净利润	-998.00	-5,342.93	-4,807.96	-5,705.42
同比变动比例	38.89%	-11.13%	15.73%	-266.78%

为扭转公司现状,维护公司及中小股东的利益,公司制定了“内生+外延”的发展战略,在采取策略应对主业承压的同时,积极寻求新的业务发展机遇,通过外延式并购调整业务布局,谋求第二主业,寻找新的利润增长点,以提升公司整体业绩。

(四)国产半导体设备市场需求有较大提升空间,符合公司战略方向

半导体产业是信息技术发展的核心基础,是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展,从政策和资金上对国内半导体产业给予了大力扶持。半导体设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试工序和实现技术进步的关键。由于我国半导体设备产业整体起步较晚,目前国产规模仍然较小、国产化提升空间较大。2016-2021年,中国大陆的半导体设备市场规模从64.6亿美元增长到了296.2亿美元,年CAGR达36%,在全球市场中的占比由15.7%提升至28.86%。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。

市场规模方面,中国大陆的半导体设备市场规模从2016年的64.6亿美元增长到2021年的296.2亿美元,年复合增长率(CAGR)为36%,高于全球同期的复合增长率。2021年,中国大陆的半导体设备市场规模占全球市场的28.86%,仅次于韩国(31.03%)和中国台湾(29.04%)。

(五)国产半导体设备市场需求有较大提升空间,符合公司战略方向

半导体产业是信息技术发展的核心基础,是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展,从政策和资金上对国内半导体产业给予了大力扶持。半导体设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试工序和实现技术进步的关键。由于我国半导体设备产业整体起步较晚,目前国产规模仍然较小、国产化提升空间较大。2016-2021年,中国大陆的半导体设备市场规模从64.6亿美元增长到了296.2亿美元,年CAGR达36%,在全球市场中的占比由15.7%提升至28.86%。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。根据SEMI统计,2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,首次在全球市场排名首位,在全球市场中的占比达15.7%,比第二名韩国高出0.6个百分点。

市场规模方面,中国大陆的半导体设备市场规模从2016年的64.6亿美元增长到2021年的296.2亿美元,年复合增长率(CAGR)为36%,高于全球同期的复合增长率。2021年,中国大陆的半导体设备市场规模占全球市场的28.86%,仅次于韩国(31.03%)和中国台湾(29.04%)。

(六)行业发展趋势

1、设备将向高精度化与高集成化方向发展

随着半导体技术的不断进步,半导体器件集成度不断提高。芯片特征尺寸不断缩小,硅片尺寸却不断扩大,半导体器件的结构也趋于复杂。因此对半导体设备的精度与稳定性的要求越来越高,未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展。

2、各类技术等级设备并存发展

虽然半导体技术持续迅猛发展,未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展,但是由于芯片的用途极其广泛,性能要求及技术参数等差异较大,各类性能、用途芯片大量并存并应用,这也决定了不同的芯片产线需配置相匹配的、技术等级及性价比相当的半导体设备。因此,高、中、低各类技术等级的生产设备均有其对应市场空间,并存发展。

3、国产化进程加快

近年来,在国家政策的拉动和支持下,我国半导体产业快速发展,整体实力显著提升,设计、制造能力与国际先进水平不断缩小,封装测试技术逐步接近国际先进水平,但半导体基础材料研究和先进设备制造仍然相对薄弱。为推动我国半导体产业的发展,国家先后设立国家重大专项和国家集成电路基金;地方政府也推出地方版集成电路投资基金,为半导体产业发展破解融资瓶颈提供了保障,有力促进了半导体行业的可持续发展。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,本土半导体及其设备制造业迎来了前所未有的发展契机,有助于我国半导体设备行业技术水平提高和行业的快速发展,从而进一步加快我国半导体设备的国产化进程。

二、标的资产的主要经营模式,并结合标的资产的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率等,分析标的资产的行业地位和竞争优势

(一)标的资产的主要经营模式

1、盈利模式

标的公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,通过向下游集成电路制造与封测领域公司销售清洗机、腐蚀机、烘箱、分片机等产品实现收入和利润,标的公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售,同时有少量设备相关配件销售及维修服务收入。

2、研发模式

标的公司主要采用自主研发的模式,不存在合作研发或者委托开发。标的公司研发部门以半导体专用设备国际技术动态、客户需求为导向,自主研发新工艺、新技术,并进行技术方案的验证。

3、采购模式

标的公司在满足客户需求基础上,以相对经济的方式组织物料采购及生产作业。对较短交期及通用、有现货的原物料件,标的公司按生产计划管理的原则按需采购;对于长交期料件,标的公司则会依据市场预测及生产计划管理采购备货式生产,通常对于高价长交期物料,公司将与供应商协商开放式的订单,确保供应稳定及价格的弹性。

4、生产模式

标的公司主要实行订单式生产,在与客户签订订单或确定意向后,根据客户需求进行产品定制化设计及生产制造,以满足客户差异化需求。受标的公司发展历史影响,同时出于控制成本、保障交期的目的,标的公司现阶段半导体设备中使用的部分关键零部件及材料主要从海外采购或外协生产。本次交易完成后,标的公司将逐步实现核心部件的采购及外协组装转移至境内。

5、销售模式

标的公司采用“直销为主、代销为辅”的模式销售产品,主要通过商务谈判、招投标等方式直接获取订单,也存在通过代理商代销少量产品。

(二)标的资产的研发能力

标的公司自成立起即专注于研发半导体设备。湿制程方面,标的公司自主研发的湿制程设备8腔设计运用业界前沿、支持晶圆正负5mm翘曲;清洗机在集成电路后道先进封装领域技术水平与国际知名企业基本持平,并持续向前道工艺拓展;干制程方面,标的公司是行业少有的推出全自动烘箱的企业,公司的烘箱可同时烘烤104片,占地空间小节省一半空间,且四腔体皆可独立配方运作;涂胶显影设备方面,标的公司的技术水平仍弱于国际知名企业,从技术发展趋势上来看,与曾与国际领先水平尚有差距,但发展势头强劲。

(三)标的资产的市场占有率及行业地位

近年来随着中国半导体终端应用市场规模的不断增长,中国半导体制造、封测、材料和专用设备等子行业发展迅速。但目前国内半导体专用设备厂商与国际巨头相比,在适用技术节点、市场占有率等方面仍有一定的差距。

半导体设备行业是典型的技术密集、资金密集型行业,具有较高的技术和资金门槛,同时由于对半导体生产环节具有重要影响,厂商不会轻易更换设备供应商,因此同时兼具一定的客户认知门槛,上述门槛和壁垒导致国产半导体设备供应商较少。苏州桔云科技有限公司(以下简称“苏州桔云”、“标的公司”、“标的资产”)专注于后道先进封装领域的研发,并逐步向前道拓展,围绕清洗设备、烘箱设备等持续深耕细作,形成自身独特的产品及技术优势,并凭借其较高的性价比优势和定制化、快速响应的客户服务优势不断扩大市场份额。产品和技术方面,标的公司自主研发的清洗设备在后道先进封装领域技术相对领先,在定制化服务、交货周期等方面有一定竞争优势,能够深度绑定知名客户,并已基本具备出货前道的技术能力;自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化,同时烘烤104片,大幅提升生产效率,国内厂商尚无对标产品。客户方面,标的公司已建立良好合作关系的客户包括江阴长电先进封装有限公司、浙江禾芯集成电路有限公司、江苏芯德半导体科技有限公司、全球化半导体设计与制造企业U'C公司等知名半导体企业。标的公司产品在优质客户中已取得良好的口碑和市场影响力,并凭借长电科技等知名客户进一步增强其市场地位和知名度,为后续持续提高市场份额奠定了坚实的基础。

(四)通过收购标的公司获得优质资产,提升公司资产质量

在公司现有主营业务市场竞争加剧且难以实现重大突破的情况下,为切实保护公司中小股东的利益,优化公司现有业务结构并提高公司持续盈利能力,公司拟收购标的公司51%股权从而取得其控制权。标的公司盈利能力良好且处于快速发展阶段,2021年实现净利润约630万元,2022年、2023年、2024年承诺扣非后净利润分别不低于1,350万元、1,890万元、2,646万元,净利润保持快速增长趋势。通过跨界收购标的公司,为公司注入盈利能力更强的优质资产,公司可以实现从传统电线电缆行业向半导体专用设备行业的拓展,提升公司资产质量,逐步改变公司现状,有利于充分保障公司及中小股东利益。

综上,虽然本次交易属于跨界收购,但在公司现有主业逐年下滑、面临压力的情况下,标的公司所处的半导体设备市场保持了快速增长态势,同时标的公司具有一定的产品和技术优势,并获得长电科技等优质客户资源,未来发展前景较好。通过本次交易,公司收购符合国家产业政策、盈利能力较强并处于快速成长期的优质资产,有望提升公司资产质量,符合公司和全体股东的利益。

二、结合公司在半导体领域已有的技术、人才储备、市场资源等,说明公司是否具备充足的资金投入能力和业务整合能力,本次收购决策是否审慎合理,是否符合公司发展战略,并充分提示该投资事项可能面临的风险

(一)本次交易存在一定的整合风险,但公司已制定相应的整合应对措施

本次交易是公司向半导体领域发展的重要战略举措。但由于公司与标的公司的主营业务差异较大,在经营模式、技术特点、管理体系、企业文化等方面存在一定差异,公司并无相关运作经验,因此与标的公司能否顺利实现整合具有一定的不确定性。如果整合措施不当或整合时间过长,或出现其他因素导致整合过程不顺利,可能导致本次交易效果不及预期,本次交易存在一定的整合风险。

为最大化实现本次交易的战略目的,公司将集中优势资源与标的公司快速整合,并助力标的公司持续快速发展。公司将采取以下措施,以实现对标的公司的有效整合,具体情况如下:

1、公司治理层面:对标的公司董事会进行改选,进一步完善标的公司内部控制制度,加强对标的公司的控制。根据协议约定,交易完成后标的公司董事会由三名董事组成,其中由公司提名两名董事候选人,由交易对方提名一名,通过上述安排,一方面公司可以实现对标的公司战略决策层面的控制并行使股东权利,及时了解标的公司的经营情况;另一方面,标的公司现任实际控制人ANG SENG THOR仍担任董事长,可实现上市公司与标的公司治理层的快速融合,相互借鉴对方先进的管理模式和管理经验。

2、业务执行层面:公司通过委派财务负责人以掌握标的公司具体各项运营及财务信息,标的公司的财务由公司统一管理,其基本财务核算原则应符合公司的要求。同时根据协议约定,公司将严格按照管理制度对标的公司进行管理:按照一般管理的公司的章程、法定代表人、董事、总经理、财务负责人、董秘、营业执照等变动情况,及时向上市公司相关审议、披露流程执行标的公司的重大合同、对外借款、担保等事宜。通过上述措施,借助公司规范化、系统化的管理体系对标的公司各项运营、财务、人事等信息予以实时监控和管理。在对标的公司管控的同时,公司仍将充分发挥标的公司原有管理团队和业务团队在半导体设备领域的专业运营能力,提升经营业绩,共同实现公司股东价值最大化的目标。公司也将持续为标的公司的发展提供支持,依靠自身的平台、资金、渠道等资源优势,加大对标的公司研发、技术、资金、团队等各方面的投入,加强新客户、新产品、新市场的开拓,持续增强其市场地位和盈利能力。

3、人才管理层面:公司充分认可标的公司的管理团队及技术团队。公司在管理层面将保留标的公司现有的核心管理团队,由其负责标的公司日常经营管理工作;在业务层面对标的公司授予较大程度的自主权和灵活性,保持其原有的业务团队及管理风格,并为标的公司的业务维护和拓展提供充分的支持。团队的维持和激励方面,交易协议中约定,标的公司主要管理团队及技术团队成员的劳动合同期限不得短于本次交易完成后三年,并应签署竞业禁止协议,以实现对团队的管理。本次交易完成后,公司也将进一步探索与市场相适应的薪酬及激励制度,激发员工积极性。

综上,本次交易完成后,公司将在公司治理、业务执行、人才管理等方面与标的公司进行整合,进一步完善标的公司的内部控制制度,充分发挥双方的优势资源,在给予标的公司较大自主权和灵活性的同时,加强对核心团队的管理和激励,实现上市公司与标的公司的快速整合,降低整合风险。

(二)本次收购决策审慎合理,符合公司发展战略

本次交易前,公司主要从事电线电缆业务,上述业务市场规模下滑且行业竞争加剧,导致公司业务规模逐年下滑,亟需开拓新的利润增长点,寻求新的业务发展机遇。半导体产业是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,而半导体设备又是半导体产业的基础,市场需求保持快速增长态势,国产化提升空间较大,符合公司战略方向。标的公司具有一定的产品和技术优势,并获得长电科技等优质客户资源,未来发展前景较好。通过本次交易,公司收购符合国家产业政策、盈利能力较强并处于快速成长期的优质资产,可优化业务布局,符合公司和全体股东的利益,因此本次收购决策审慎合理。

(三)风险提示

1、技术、人才短缺风险。本次交易前,公司未涉足半导体专用设备行业,且该行业与公司现有主营业务差异较大,公司并无相关运作经验,在技术储备和人才储备方面存在一定不足,可能存在技术、人才短缺的风险。公司后续拟保留标的公司现有的核心管理团队,发挥其专业运营管理能力,并进一步扩大强化标的公司的研究发和销售团队。

2、资源协同整合风险。本次交易完成后,公司将尽最大努力为标的公司提供持续支持,依靠自身的平台、资金、渠道等资源优势,加大对标的公司研发、技术、资金、团队等各方面的投入。但公司在对标的公司进行有效管控的基础上,能否保持并提升其运营效率和效益,进而实现资源的有效协同整合具有一定的不确定性,公司可能面临资源协同整合效果不及预期的风险。

3、整合风险。公司与标的公司的主营业务差异较大,在经营模式、技术特点、管理体系、企业文化等方面存在一定差异,虽然公司已制定整合计划和整合措施,但由于公司并无相关领域运作经验,与标的公司能否顺利实现整合具有一定的不确定性。如果公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要,或出现其他因素导致整合过程不顺利,可能导致对标的公司的整合效果不达预期,本次交易存在一定的整合风险。

三、结合公司本年度目身经营情况,说明若不进行本次收购,公司今年业绩是否可能触及退市风险警示相关指标,本次收购是否涉及年末突击交易

2022年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司经营地上海地区物流受阻,公司的生产、销售、运输、原材料供应等受到了极大的不利影响。疫情缓和之后,公司积极组织复工复产,截至2022年9月30日,公司实现营业收入7,322.96万元(以上数据未经审计),截至2022年10月31日,公司实现主营业务收入约8,900.00万元(以上数据未经审计)。目前公司业务运营正常,根据公司在手订单和下游客户需求情况预测,后续每月可实现营业收入1,000.00万元以上,全年主营业务收入预计可实现1亿元以上。因此,若不进行本次收购,公司今年业绩预计不会触及退市风险警示相关指标,但仍不排除受新冠肺炎疫情等因素的影响公司全年主营业务收入无法实现1亿元的可能。

公司实际营业收入以2022年年度报告披露的审计数据为准,以上均为基于在手订单和运营情况的预测数据。以上预测数据不能作为投资依据,敬请广大投资者注意投资风险。

在公司现有业务逐年下滑的情况下,为扭转公司现状,维护公司及中小股东的利益,公司制定了“内生+外延”的发展战略,在采取策略应对主业承压的同时积极寻求新的业务发展机遇,通过外延式并购谋求第二主业,寻找新的利润增长点,以提升公司整体业绩。公司最早于2022年8月筹划本次交易,经过公司及相关中介机构的深入尽调及多轮谈判后审慎决策,于2022年8月30日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署(收购意向协议)的议案》;于2022年11月8日召开公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案》,并与交易对方签署了《购买资产协议》,在《购买资产协议》中通过协议生效条件、交割条件、交易对价支付条件等条款的约定维护公司及中小股东的利益。因此,本次收购属于公司为谋求新发展正常筹划的交易行为,不涉及年末突击交易。

四、公司全体董事、监事、高级管理人员意见

经核查,公司全体董事、监事、高级管理人员认为:

1、本次交易系公司现有主业逐年下滑、面临压力的情况下,为改善公司资产和经营状况而进行的跨界收购,具备必要性;本次收购决策审慎合理,符合公司发展战略;

2、本次交易存在一定的整合风险,但公司已制定相应的整合应对措施,在公司治理、业务执行、人才管理等方面与标的公司进行整合,充分发挥双方的优势资源,降低整合风险;

3、目前公司业务运营正常,若不进行本次收购,公司今年业绩预计不会触及退市风险警示相关指标,本次收购不涉及年末突击交易。

问题2.公告披露,本次交易评估基准日为2022年6月30日,标的公司净资产为802.64万元,采用收益法、市场法的评估值分别为2,26亿元、2.25亿元,最终选取市场法为定价依据,增值率1210.36%,公告未披露评估过程。双方协商后标的资产51%股权的交易作价为1.1934亿元,略高于评估值。请公司:(1)补充披露市场法的评估过程,可比交易案例的基本情况及选取依据;补充披露收益法的测算过程、收入增长率、折现率等主要参数及选取依据;结合上述情况,说明标的资产评估溢价率较高的原因;(2)补充披露市场法的评估过程,可比交易案例的基本情况及选取依据;结合上述情况,说明标的资产评估溢价率较高的原因;(3)说明最终交易价格相较评估值有所增加的原因,是否存在损害上市公司利益的情况。请评估师发表意见。

答复:

一、补充披露市场法的评估过程,可比交易案例的基本情况及选取依据;补充披露收益法的测算过程、收入增长率、折现率等主要参数及选取依据;结合上述情况,说明标的资产评估溢价率较高的原因

(一)市场法的评估过程

1、整体思路

根据本次评估目的及标的资产的实际情况,分别采用上市公司比较法和交易案例比较法对标的资产的股东全部权益价值进行测算,取两种比较法的平均结果作为标的资产股东全部权益价值的市场法评估结果。

虽然标的资产上半年收入、净利润情况受到疫情影响存在收入确认延后导致整体业绩规模较小,但随着下半年的生产、出货、验收等环节的恢复与加速,其收入、净利润全年预期规模恢复至正常生产经营水平,可以体现标的资产基准日时点的正常经营水平和盈利能力。考虑到标的资产成立时间较短,股东注册资金尚未全部实缴,且当前主要生产经营场所以租赁为主,其注入的专利技术等无形资产价值也未在账面体现,基准日时点标的资产账面净资产水平无法全面反映其资产与实际生产经营能力相关的投资规模、资本积累等情况。因此本次采用上市公司比较法和交易案例比较法均选取了市盈率(PE)与市净率(PB)两种价值比率,并依据标的资产管理层制定的2022年预期收入规模及净利润规模进行测算,未选用市净率(PB)作为价值比率。具体思路如下:

(1)上市公司比较法评估思路

1)选取与标的资产属于同一行业,从事相同或相似的业务、受相同经济因素影响的可比上市公司。

2)通过同花顺终端获取可比上市公司于评估基准日的PS、PE水平,考虑到同一行业中可比上市公司的价值比率水平可能存在极值影响,本次评估以同行业上市公司PS、PE的中位数作为价值比率。

3)由于标的资产为非上市公司,其股权价值在流动性差异,需要进行流动性折扣修正。

4)根据标的资产管理层预测的2022年全年收入与净利润规模,分别结合修正后的可比上市公司PS、PE倍数中位数测算,得出两种结果后取平均值作为上市公司比较法评估结果。

(2)交易案例比较法评估思路

1)选取基准日前十年间,即2012-2022年间,发生的与标的资产生产经营模式相近,受到相同或相似经济因素影响的交易案例,剔除掌无法获取详细外招、财务信息的交易案例,得到可比交易案例样本。

2)根据可比交易案例对应的公告、财务数据等信息,得出可比交易案例于交易定价基准日的PE、PS价值比率。

3)根据标的资产管理层预测的2022年全年收入与净利润规模,对各交易案例基准日与本次评估基准日上证综指指数差异进行明日调整修正,再分别结合可比交易案例PS、PE倍数平均数测算,得出两种结果后取平均值作为交易案例比较法评估结果。

2、上市公司比较法评估过程

(1)选取可比公司

标的资产主要竞争对手如芯源微等在科创板上市,而本次收购方为主板上市公司。本次选取标的资产及现有主要竞争对手和对标公司业务细分领域所在的申万一级行业分类的科创板及主板上市公司,同行业公司受到相同或相似经济因素影响,具体筛选过程如下:

1)筛选申万行业分类一级行业-电子的沪深主板及科创板上市公司;

2)剔除首发上市日至评估基准日未满一年,上市时间较短的上市公司;

3)剔除ST、*ST上市公司;

4)最后得出样本上市公司共216家。

(2)价值比率的计算

通过同花顺终端获取可比公司于评估基准日的市盈率、市销率,考虑到由于样本内存在极值影响,本次选取中位数作为价值比率。此外,由于标的资产为非上市企业,其股东权益缺乏市场流通性,因此在可比上市公司市值基础上需要扣除流动性折扣,因此在考虑上述影响下对可比公司PS、PE倍数进行调整。流动性折扣参考《Measuring the Discount for Lack of Marketability for Non-controlling,Nonmarketable Ownership Interests》中的Valuation Advisors Pre-IPO Study研究,对中国市场IPO前2年内发生的股权交易的价格与IPO上市后的交易价格的差异进行测算来定量估算流动性折扣。调整后的PS、PE情况如下:

项目	流动性折扣调整后的PS	流动性折扣调整后的PE
中位数	2.04	19.04

(3)标的资产2022年全年收入及净利润预测情况

标的资产主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售,同时配套配件、服务等相关业务。

标的资产管理层基于在手订单、在程项目、与客户洽谈的未来发展规划所预测的订单情况,以及行业发展态势等制定的2022年预测收入规模和预测净利润规模分别为8,117.44万元和1,345.51万元。

(4)计算标的资产股东全部权益价值

根据标的资产管理层2022年预期收入规模、预测净利润规模,以及计算得出的经流动性调整后的样本可比上市公司价值比率中位数水平,计算得出标的资产股东全部权益价值,具体如下:

标的资产2022年预测收入规模(万元)	调整后的样本可比上市公司PS(中位数)	对应股东全部权益价值(万元)
8,117.44	2.04	16,584.84
标的资产2022年预测净利润规模(万元)	调整后的样本可比上市公司PE(中位数)	对应股东全部权益价值(万元)
1,345.51	19.04	25,621.50
平均值		21,100.00(取整)

综上,采用上市公司比较法得出的标的资产股东全部权益价值为21,100.00万元。

3、交易案例比较法评估过程

(1)可比案例的选取

1)可比案例选择标准

通过公开信息查询,收集了近年已完成的涉及半导体设备行业的并购案例。考虑到其中部分案例存在与标的资产生产经营与业务模式差异大、可获取信息较少等情况,因此未予选取,具体未选择原因如下:

序号	首次公告日	事件名称	标的所属行业	未选取原因
1	2022/5/23	长川科技拟通过发行股份向天堂硅谷机实、Lee Heng Lee及井冈山乐橙购买其合计持有的长类科技97.6687%股权	半导体设备	在审核进程中,尚未完成
2	2022/3/29	上海贝岭股份有限公司购买深圳市矽塔科技有限公司100%股权	半导体设备	标的主要从事芯片设计,且业务模式与苏州桔云存在较大差异
3	2022/3/29	上海贝岭股份有限公司购买上海岭芯微电子有限公司30%股权	半导体设备	标的主要从事芯片设计,且业务模式与苏州桔云存在较大差异
4	2021/4/24	光力科技股份有限公司收购控股子公司先进微电子装备(郑州)有限公司股权	半导体设备	可获取的交易信息及财务数据较少
5	2019/6/11	上海广奕电子科技股份有限公司3.25%股权权益变动	半导体设备	可获取的交易信息及财务数据较少
6	2019/5/29	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司出售沈阳拓荆科技有限公司4.215%股权	半导体设备	可获取的交易信息及财务数据较少
7	2018/9/25	恒润股份收购江阴市光科光电精密设备有限公司股权	半导体设备	未查询到具体生产经营模式
8	2018/6/1	赛腾股份投资无锡昌鼎电子有限公司项目	半导体设备	可获取的交易信息及财务数据较少

剔除上述案例后,最终选取了如下3个案例:

序号	收购方	交易标的	评估基准日
案例一	万业企业	凯世通49%股权	2018年3月31日
案例二	正业科技	集银科技100%股权	2015年6月30日
案例三	长川科技	长新投资90%股权	2018年9月30日
本次评估取值			2022年6月30日

虽然本次选择的3个交易案例的基准日与本次评估基准日时间存在一定差异,但是他们具有①交易标的均以半导体生产相关设备行业为主的公司,与标的资产在宏观经济影响因素、行业发展影响因素等方面具有相同与相似性;②交易标的主要生产经营模式主要以根据客户定制化需求进行设计,通过采购核心设备进行组装生产后为客户装配,与标的资产的生产经营模式相似度较高;③均为上市公司收购案例,具有较完善的公开信息,且与本次评估目的经济行为一致;本次选择的可比交易案例与本次交易及标的资产相似性较高,选取具备合理性。

2)可比案例介绍如下

案例一:

案例一标的主营业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务,主要产品为离子注入机。重点发展长阳能离子注入机、集成电路离子注入机和离子注入机三大类设备。具体采购生产模式如下:

案例标的获取订单后,召集技术、财务、销售等部门对项目进行评审,评审通过后与客户签订合同,研发人员会对技术方案进行设计并向采购部下达采购需求,采购部会按照采购需求进行采购,生产部门收到物料后开始设备组装生产,组装生产完毕后对设备进行测试,设备测试通过后会对设备进行分拆并包装发送至客户,在客户处组装设备,设备调试经客户验收后移交客户。

案例二:

案例二标的是一家专业从事液晶模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售的高新技术企业,其主要产品广泛应用于液晶模组的生产全过程,覆盖了LCD模组生产、背光源生产、LCM模组生产和TP+LCM模组生产等四个生产领域。具体采购生产模式如下:

案例标的主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购方式,根据客户订单安排原材料采购,采取自行加工和直接外购经加工的零部件相结合的模式,主要生产环节为装配和检测。在产品运抵客户后,售后人员会前往现场进行产品的调试和安装工作,确保设备的正常运行,并提供设备操作的培训。

案例三:

案例三标的是一家持股平台,旗下主要核心资产为实际经营体S公司主要进行研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备。具体采购生产模式如下:

S公司生产流程从客户下单开始,接受客户订单,制造部门确定客户订单中产品规格,由制造部发布购买请求,采买后经质检部门检验后将部分产品送达制造处,制造部门进行模型和机器装配、建立系统/机器,进而机器买通验证,最后发出装船请求。

(2)价值比率的计算

根据上市公司公告等公开信息,对可比案例对应公告进行了信息整理与分析,按照最终交易对价对应的标的100%股权价值,交易定价参考依据的基准日及其全年预测收入、预测净利润得出可比案例的PS、PE指标。此外,由于可比交易案例基准日与本次评估基准日存在时间差异,因此本次参考上证综指于各交易案例基准日与本次评估基准日时点的差异进行期日调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	收购方	交易标的	评估基准日	期日调整系数	调整后的PS	调整后的PE
案例一	万业企业	凯世通49%股权	2018年3月31日	1.07	5.56	20.75
案例二	正业科技	集银科技100%股权	2015年6月30日	0.79	2.58	12.78
案例三	长川科技	长新投资90%股权	2018年9月30日	1.20	1.75	13.37
本次评估取值			2022年6月30日		3.30	15.63

注1:案例三为持股平台,本身不从事生产经营活动,旗下核心资产为S公司,上表相关财务数据以S公司数据为准。

注2:上表中全年收入、全年净利润系根据上述交易公开披露信息中心标的资产于基准日时点的经审计后的收入(净利润)+基准日后至当年年末的预测收入(预测净利润)。

(3)标的资产2022年全年收入及净利润预测情况

标的资产主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售,同时配套配件、服务等相关业务。

标的资产管理层基于在手订单、在程项目、与客户洽谈的未来发展规划所预测的订单情况、以及行业发展态势等制定的2022年预测收入规模和预测净利润规模分别为8,117.44万元和1,345.51万元。

(4)计算标的资产股东全部权益价值

根据标的资产管理层2022年预期收入规模、预测净利润规模,以及计算得出的可比交易案例价值比率平均水平,计算得